

임소정의 소부장 한 주 정리하기



반도체 소부장 위클리 | 2025.12.03

고성능 메모리를 노리는 새로운 사람들



반도체 임소정_02)368-6154_sophie.yim@eugenefn.com

유진투자증권

<위클리 소부장 주가 코멘트>

국내 소부장 기업들의 주가는 반도체 시장에 대한 우려가 줄어들면서 전영역 모두 반등. 특히 구글 TPU에 대한 기대감에 후공정 테스트 부품사들 주가가 강했고, 일본의 중국향 반도체 소재 수출 통제에 따른 한국 반사 수혜 기대감으로 동진세미캠 등이 10% 넘게 상승. 종목별로는 에이팩트의 경우 SOCAMM2 테스트 양산을 위한 인프라 공사 언급에 25% 상승했고, 의료로봇 판매 본격화로 고영은 한 주간 25% 상승의 강세를 보임. 코세스는 미국 블룸에너지에 178억 원 규모로 장비를 단독 공급한다는 소식에 10% 넘게 상승. 주목할 경제 지표: 3일 ADP 비농업부문 고용 변화, Marvell 실적발표 5일 9월 PCE 가격 지수, 12월 미시간대 소비심리지수

<글로벌 기업>

- **알칩**, Ayar Labs와 함께 TSMC 기반 실리콘 포토닉스 플랫폼 '쿠페' 솔루션 공개
- **마이크론**, 일본에 14조 원 투자하며 HBM 신공장 구축. 내년 5월 착공 예정이며 2028년부터 출하 목표
- **인텔**, 2027년 애플의 M 시리즈 SoC 위탁 생산 수주 가능성 확대. TSMC의 수주량에는 거의 영향이 없을 것으로 예상. 하지만 애플의 이원화와 인텔의 신규 수주 확보 면에서 의미가 있다고 평가

<금주의 Key Chart: 반도체 시장 3개의 기둥>

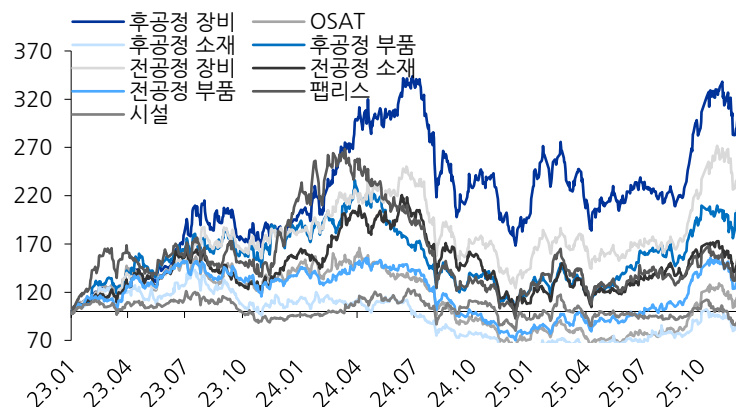
영역	기업명	개발 현황 및 전망
ASIC	Google Amazon	TPU와 Trainium 성능 개선으로 2026년 출하량 증가 전망
CPU	Intel Qualcomm AMD	주요 수요처였던 컨벤셔널 서버 시장 이외 AI 서버 시장 진출 본격화로 실적 개선 기대감 유효
HBM	SK 하이닉스 Marvell Synopsys	높은 대역폭과 효율적인 데이터 접근이 동시에 요구되는 AI 추론 및 연산 시장 수요에 대응

자료: 유진투자증권

<국내 기업>

- **삼성전자**, 화면을 2번 접는 '갤럭시 Z 트라이폴드' 12일 국내 출시 예정, 가격은 359만 4백 원
- **소테리아**, ICCAD China 2025에서 차세대 EDA 툴 'DEF 지니' 공개. 커스텀과 SoC 간 레이아웃 호환성 확보가 포인트
- **딥엑스**, 현대차, 기아 로보틱스랩과 함께 차세대 로봇용 온디바이스 AI 플랫폼 공개. 실내외 서비스 로봇에 적합한 구조

<소부장 영역별 지수 그래프>



자료: 유진투자증권

<이외>

- **반도체특별법**, 정부의 반도체 산업 재정 지원 의무 조항 빠진 채로 국회 본회의 처리 예상. 직접 지원 근거를 명시하고 싶었으나 WTO 통상 리스크를 감안
- **일본**, 중국향 포토레지스트 수출 통제로 SMIC와 화홍 파운드리 등 3~6개월 내 가동 압박. 한국은 2019년 수출 통제 사태 이후 자급망 체제 구축하며 공급 채널 관리하며 수급에 문제없는 상황

반도체 시장 3 개의 기둥: ASIC, CPU, Customized HBM

도표 1. ASIC, CPU, HBM 업체들의 AI 반도체 업데이트

영역	기업명	3Q25 실적 발표 주요 사항	시총 (십억달러, 십억원)	개발 현황
ASIC	Google	Cloud 부문 매출 152억 달러 기록, 전년대비 +34% 성장. 자체 개발 TPU가 포함된 AI 최적화 스택 수요 증가	1,703.9	7세대 TPU인 Ironwood를 포함한 AI 칩 인프라를 통해 AI 워크로드 대응 능력 강화, Full-Stack AI 전략 강조. Custom TPU와 자체 AI 모델, 클라우드와 SaaS로 이어지는 수직 통합 AI 생태계 구축
	Amazon	AWS 부문 매출 330억 달러 기록, 전년대비 +20% 성장. Trainium 비즈니스 전분기대비 +150% 성장	2,500.2	2015년 인수한 안나푸르나 랩(Annapurna Labs)의 반도체 자체 개발 역량을 강조하며 코어 서비스에서의 자체 칩 채택률 50% 이상을 달성. 추론형 AI 엔진으로 Amazon Bedrock과 Trainium 조합을 중시하며 3세대 칩은 2026년 초부터 양산 예정, TrendForce는 해당 칩 출하량 2배로 예상
CPU	Intel	핵심 제품인 x86 CPU 플랫폼 뿐만 아니라 주문형 ASIC, 가속기, 파운드리 등 전방위적 수혜가 이어지고 있음을 언급	190.9	컨벤셔널 서버에 들어가는 단순한 CPU 공급자에서 벗어나 AI 서버 및 데이터센터용 인프라와 파운드리, 가속기를 모두 포함 및 제공하는 포트폴리오로 확장하려는 전략 제시. DCAI 매출은 전분기대비 5% 증가한 수준. AI 서버용 GPU 가속기인 Crescent Island는 GPU와 LPDDR5X가 탑재되어 비용과 전력의 효율성 및 공랭 서버 호환성에 유리
	Qualcomm	AI 데이터센터용 타겟한 AI200과 AI250 SoC 출시, 업계 최고 수준의 TCO, 연 단위로 신세대 출시 예정	179.6	AP와 NPU 등에 집중해온 퀄컴은 올해 10월 말 AI 가속기 칩인 AI200과 AI250을 공개하여 AI 데이터센터 시장 진출을 공식화. AI 서버 시장 내 기존 GPU의 computing intensive 한 경쟁과 달리 저전력과 저비용, 추론 최적화라는 computing efficient 한 컨셉을 강조
	AMD	데이터센터용 매출 43억 달러 기록, 분기 기준 사상 최대치. 5세대 CPU인 Turin과 AI 가속기 GPU인 MI350 시리즈가 호실적을 견인	357.8	CPU 진영 기업들 가운데 가장 먼저 GPU 형태의 AI 가속기를 출시했고, 데이터센터용 CPU+GPU 통합 솔루션을 제공. 최근에는 EPYC CPU와 Instinct MI GPU가 결합된 구조의 솔루션을 소개하며 학습과 추론 모두 지원할 수 있는 성능을 구현하는 중
cHBM	SK하이닉스	2026년 양산 예정인 HBM4에 대해 베이스 다이는 TSMC의 선단 로직 공정 활용할 전망	391,665	HBM4부터 베이스 다이에 파운드리 공정 적용이 가능해지면서, 커스텀 HBM에 대한 수요가 강력할 것으로 전망. 일부 하이퍼스케일러 업체들은 스탠다드 메모리뿐만 아니라 커스텀 HBM 설계를 요구하고 있고, 2026년부터는 두 트랙으로 갈 것으로 예상. 다만 커스텀 칩 개발에 따른 펌 운영 및 관리 면에서의 리스크 존재
	Marvell	AI 데이터센터 시장 포지셔닝 강화를 위해 cHBM 아키텍처와 cSRAM, CPO를 포함한 인프라 전략을 제시	78.5	올해 초 클라우드 고객사 및 HBM 업체들과 협력하여 Marvell Custom HBM Compute Architecture를 공식 발표. 올해 6월에는 2nm 기반 Custom SRAM을 발표했고, 이후 메모리 계층 전체를 포괄하는 메모리+가속기+인터커넥트 솔루션을 제시
	Synopsys	Ansys 인수를 통해 AI 칩 및 시스템 설계의 기초가 되는 설계 및 검증 인프라 확대	81.4	올해 8월 메모리 제조사들의 cHBM 설계를 위해 필요한 로직 다이의 IP와 AI 설계 툴 등 여러 기술을 적용하고 있다고 언급

자료: 각 사, 유진투자증권

국내 반도체 업체로의 수혜

새로운 칩 개발에
따른 R&D 매출의
증가 기대해볼 수
있는 부품사

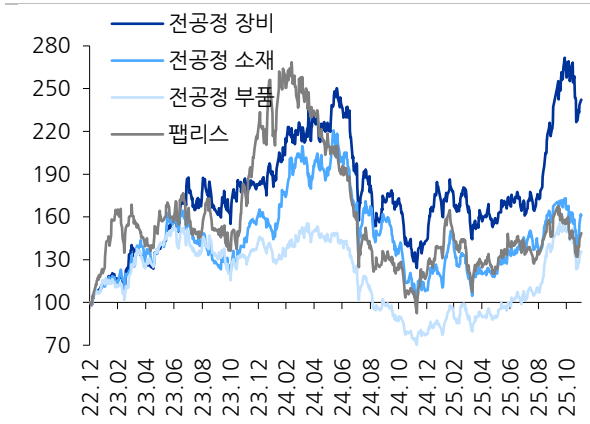
CPU 와 ASIC 진영 기업들의 AI 서버 시장 진출로 수혜를 볼 수 있는 분야로 테스트 부품사를 제시한다. 특히 **리노공업**은 상기한 도표의 기업들 대부분을 고객사로 확보하고 있고, 가장 매출 비중이 높은 고객사의 경우 AP 뿐만 아니라 CPU, AI 칩 등 다양한 신규 제품을 개발 중에 있다. 이러한 신규 칩 개발 과정에서 테스트를 위한 소켓 주문의 대부분을 리노공업이 소화하고 있으며, 특히 AP 에 비해 CPU 와 AI 칩은 면적이 넓기 때문에 단가 상승 효과가 있다.

한편 실리콘 소켓 제조업체인 **ISC** 의 경우 3Q25 데이터센터향 매출이 전체 매출 645억 원의 64%를 차지한 가운데, 앞서 언급한 ASIC 업체들로의 납품 증가가 실적을 견인했다. 특히 주요 기업에 대해 R&D 소켓은 100%, 양산용 소켓은 절반 이상을 공급하면서 고객사 내 높은 점유율을 유지하고 있다. 4 분기에도 메모리 업사이클과 AI 인프라 투자 확대에 따른 수요 증가를 기대하고 있으며, 특히 고속 신호 및 저전력 테스트의 수요 강세를 강조했다. 최근에는 모듈 테스터와 번인 테스터 등 장비 사업을 겸하기 시작하면서, 신규 사업 매출도 실적을 견인할 전망이다.

이러나저러나
메모리 업체들에겐
청신호

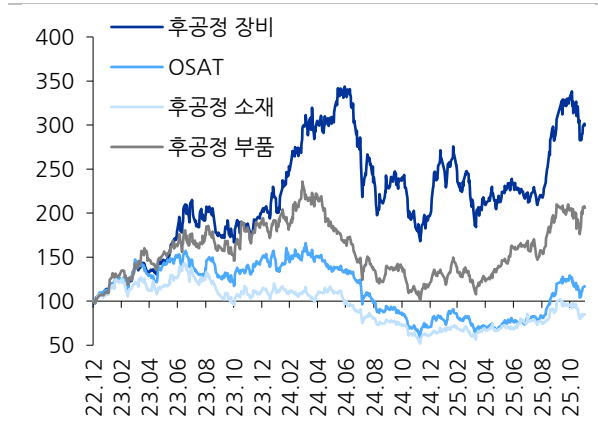
최근 시장에서 구글의 Gemini 3.0 의 성능 개선과 메타로의 TPU 공급 소식이 주목을 받으며 ASIC 업체들의 AI 서버 시장 내 영역 확대를 기대하고 있다. 특히 SK 하이닉스가 이미 cHBM 시장에 대응 중인 것으로 파악되고 있으며, 이는 메모리 제조업체들에게 GPU 업체들 외에도 고객사를 다변화할 수 있는 초기 시장이 형성되고 있다고 볼 수 있다. 또한 맞춤형으로 제품을 제공한다는 면에서 단가 프리미엄도 기대할 수 있다. 특히 CPU 진영에서 HBM 대신 LPDDR 과 GDDR 을 자사 AI 칩에 탑재한다는 점이 레거시 DRAM 수요와 가격 강세를 유지하는 데 중요한 역할을 할 것으로 판단된다. 따라서 **SK 하이닉스**와 **삼성전자**에 대해서도 탑라인 성장과 이익성 개선 측면에서 긍정적인 전망을 유지한다.

도표 2. 전공정 기업 주가 지수



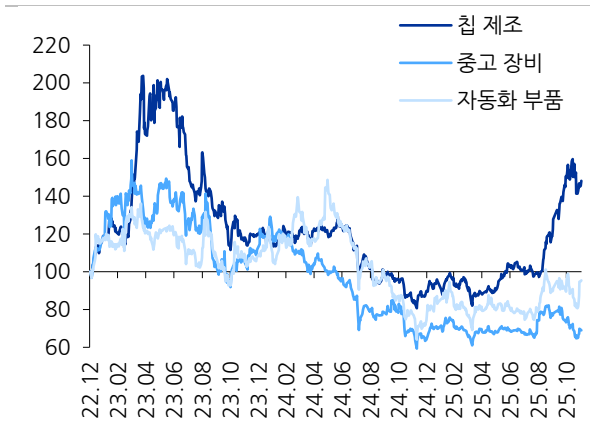
자료: 유진투자증권
주: 2023.01.02=100

도표 3. 후공정 기업 주가 지수



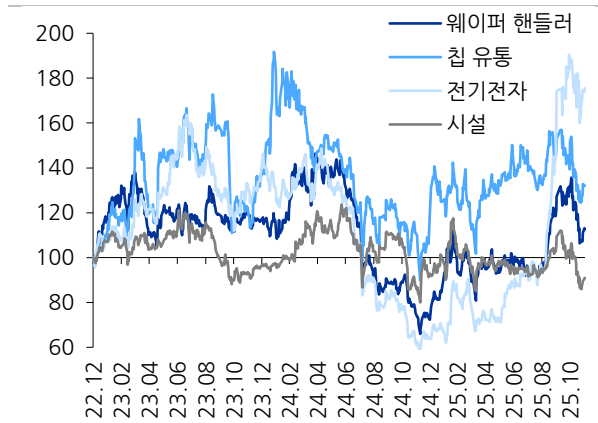
자료: 유진투자증권
주: 2023.01.02=100

도표 4. 칩 제조업체 등 이외 기업 주가 지수



자료: 유진투자증권
주: 2023.01.02=100

도표 5. 전기전자 및 팹 관련 기업 주가 지수



자료: 유진투자증권
주: 2023.01.02=100

도표 6. 유리 기판 관련주 전체 주가 지수



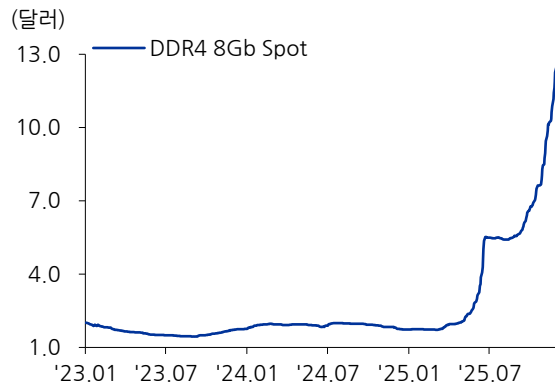
자료: 유진투자증권
주: 2023.01.02=100

도표 7. 하이브리드 본딩 관련주 전체 주가 지수



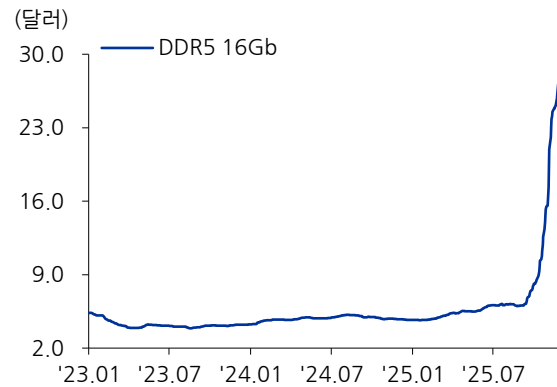
자료: 유진투자증권
주: 2024.09.27=100

도표 8. DDR4 8Gb 가격 추이 차트



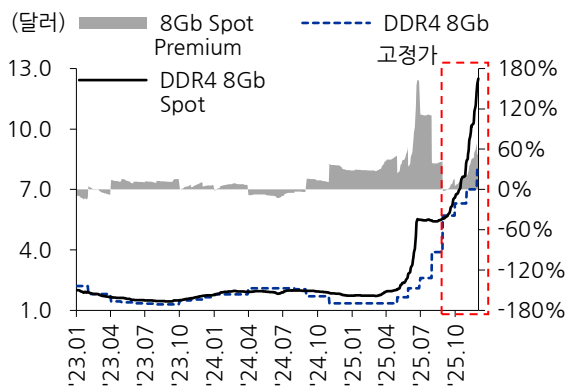
자료: DRAMeXchange, 유진투자증권

도표 9. DDR5 16Gb 가격 추이 차트



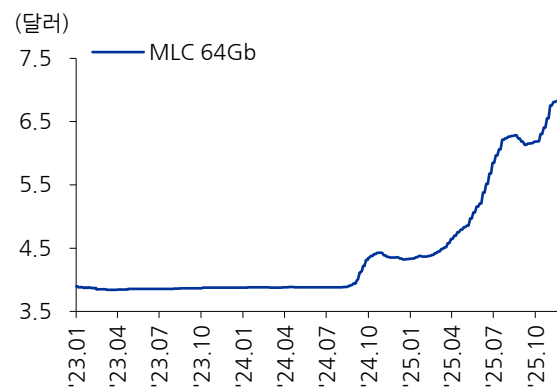
자료: DRAMeXchange, 유진투자증권

도표 10. DRAM 스팟 프리미엄



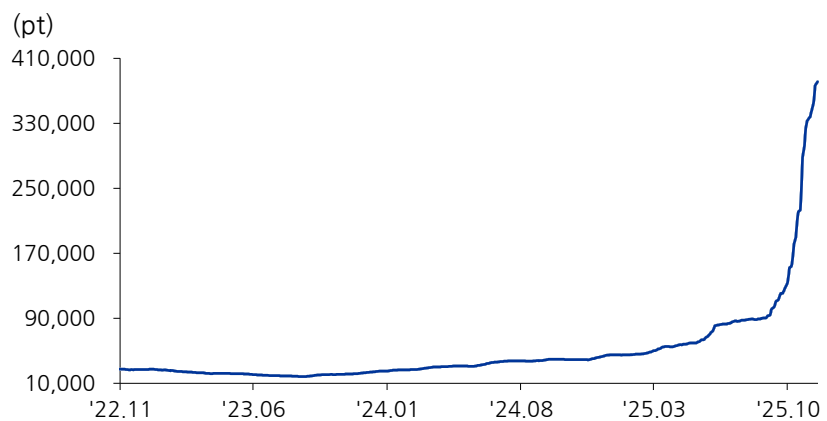
자료: DRAMeXchange, 유진투자증권

도표 11. MLC 64Gb 가격 추이 차트



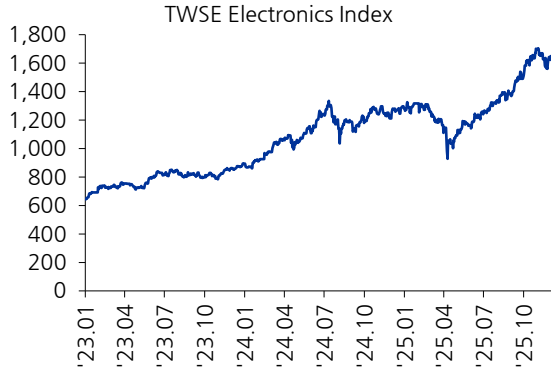
자료: DRAMeXchange, 유진투자증권

도표 12. DXI 지수



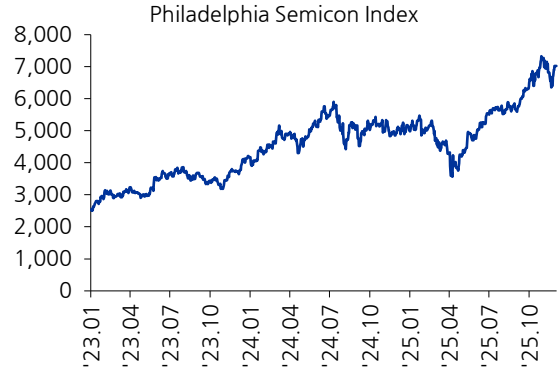
자료: DRAMeXchange, 유진투자증권

도표 13. 대만 가권 Electronics 지수



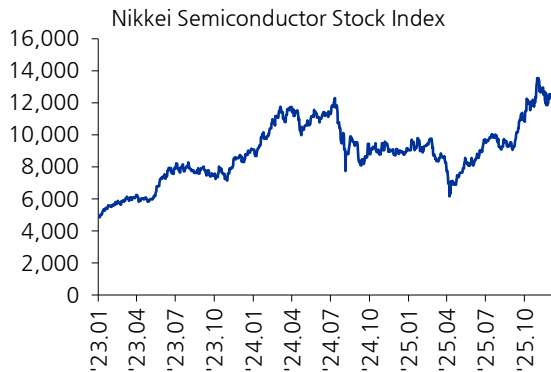
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 14. 미국 필라델피아 지수



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 15. 일본 Nikkei 반도체 지수



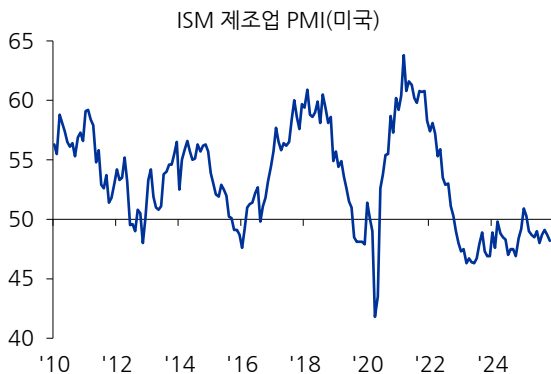
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 16. 중국 FactSet 반도체 지수



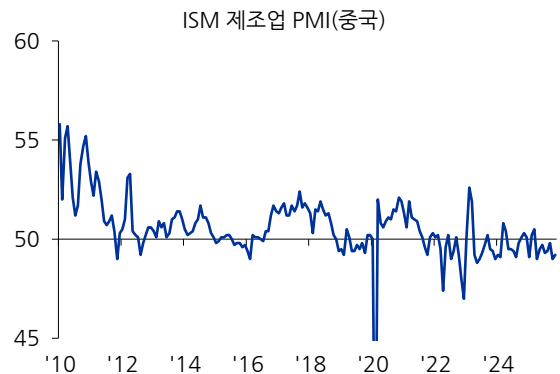
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 17. 미국 ISM 제조업 지수



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 18. 중국 ISM 제조업 지수



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 19. 국내 반도체 소부장 업체 주가 동향 및 밸류에이션

		주가	시가총액			주가 Performance(%)			밸류에이션	
			(십억)	1주	1개월	6개월	1년	PER('23P)	PER('24F)	PSR('24F)
[반도체]	삼성전자	102,350	605,579	3.7	-5.0	80.2	91.0	10.7	17.9	1.9
	SK하이닉스	554,000	403,313	7.8	-1.1	167.0	248.9	6.1	10.4	4.3
[소재]	솔브레인	284,500	2,213	17.3	0.2	76.5	63.5	10.8	20.0	2.4
	한솔케미칼	254,000	2,879	11.6	8.5	92.1	160.8	8.8	18.1	3.0
	동진세미캠	39,550	2,033	17.7	-7.6	41.5	85.2	6.9	19.1	1.7
	원익머트리얼즈	31,900	402	5.5	-1.7	56.8	88.8	6.8	9.8	1.3
	이엔에프테크놀로지	48,250	689	12.3	-2.2	67.5	206.3	7.1	11.6	1.0
	이녹스첨단소재	24,350	493	10.7	-1.4	12.5	16.5	5.5	7.2	1.1
	솔브레인홀딩스	43,000	901	16.4	0.4	45.5	22.7	12.7	-	-
	디엔에프	14,240	165	8.0	-5.3	27.4	67.7	160.4	-	-
	미코	14,240	476	6.3	-1.9	9.3	86.9	21.6	-	-
	에스엔에스텍	52,700	1,124	18.4	-8.5	55.2	141.7	17.6	25.4	4.6
[부품]	리노공업	66,400	5,060	2.9	14.9	63.5	115.2	25.7	34.7	13.5
	ISC	111,600	2,366	7.0	40.2	123.4	122.3	27.0	44.1	11.0
	티씨케이	149,700	1,748	4.2	-9.6	67.8	117.6	11.5	-	-
	하나머트리얼즈	46,500	920	8.0	13.6	83.1	103.5	14.1	27.3	3.5
	월덱스	22,650	374	6.6	-10.5	21.3	46.1	4.3	-	-
	엘오티베콤	13,070	233	8.6	0.2	47.7	65.2	81.9	-	-
	지오엘리먼트	6,460	81	5.4	-6.9	-2.0	3.4	27.2	-	-
	메카로	22,600	230	5.1	-14.1	93.3	192.4	13.5	-	-
	대덕전자	48,350	2,389	-8.6	27.4	223.2	244.1	33.6	48.9	2.3
	심텍	51,800	1,912	0.6	-18.0	189.5	385.9	-	-	1.4
	원익 Q&C	21,850	574	14.6	-7.2	32.3	22.1	9.2	21.9	0.6
	비씨엔씨	13,070	167	7.1	-12.2	43.5	56.5	-	89.8	1.8
	비에이치	17,620	594	8.6	-4.1	47.2	10.7	8.1	27.6	0.3
	코미코	89,900	940	12.2	-19.2	58.6	147.0	6.8	16.3	1.6
	샘씨엔에스	7,150	417	-1.2	-7.7	57.7	85.0	65.3	-	-
	마이크로투나노	8,710	52	4.9	-20.3	-4.1	50.4	-	-	-
	티에스이	59,600	656	16.4	15.3	49.7	62.8	10.4	19.3	1.6
	티에프이	45,400	543	-4.0	11.4	82.0	233.8	126.3	33.5	5.0
	피엠티	2,810	30	-10.2	-4.7	12.9	-4.7	-	-	-
[장비]	원익 IPS	61,600	3,024	3.9	-4.0	169.6	175.6	52.5	39.1	3.3
	유진테크	80,600	1,847	4.5	-15.6	146.9	153.1	11.0	36.2	4.9
	주성엔지니어링	30,350	1,432	15.0	-1.6	-3.3	16.7	13.0	24.9	4.4
	테스	41,400	818	8.7	-6.5	85.2	196.3	6.4	12.9	2.5
	오로스테크놀로지	23,250	218	3.6	-9.2	12.3	70.8	25.2	32.9	3.3
	HPSP	31,400	2,622	12.1	-9.4	42.7	23.6	24.7	-	-
	이오테크닉스	275,000	3,388	12.7	16.5	89.7	139.3	36.0	53.7	8.7
	피에스케이	32,950	954	12.8	-14.0	79.2	97.8	6.0	12.9	2.2
	제우스	14,430	448	12.7	-6.8	11.9	36.8	8.7	-	-
	인텍플러스	14,150	182	23.0	-2.9	58.6	59.7	-	-	2.0
	제너셈	5,330	70	1.1	-7.3	17.9	15.5	9.8	-	-
	유니셈	9,740	299	-1.4	-2.7	65.9	72.4	11.2	-	1.1
	GST	26,400	487	6.0	1.1	45.7	84.9	6.8	2422.0	-
	에스티아이	25,650	406	4.3	11.3	29.3	73.9	9.5	-	1.0
	프로텍	35,300	388	7.8	12.2	55.5	56.9	9.1	14.3	1.9
	한미반도체	121,500	11,580	1.2	-14.1	51.9	68.0	51.9	44.8	17.0
	피에스케이홀딩스	46,450	1,003	11.0	-5.7	49.4	56.7	8.6	12.6	5.1
	필옵틱스	41,750	977	6.1	-2.0	21.7	161.8	74.5	-	7506.9
	고영	27,400	1,885	43.5	64.3	76.8	243.4	25.4	158.4	8.4

자료: 각 사, 유진투자증권 추정

도표 20. 국내 반도체 팹리스 및 OSAT 업체 주가 동향 및 밸류에이션

		주가	시가총액			주가 Performance(%)			밸류에이션	
			(십억)	1주	1개월	6개월	1년	PER('23P)	PER('24F)	PSR('24F)
[파운드리]	DB 하이텍	65,500	2,850	5.8	11.4	54.8	116.5	6.0	11.4	2.1
[DSP]	에이디테크놀로지	30,700	413	28.5	16.3	109.0	122.1	-	-	-
	코아시아	5,460	144	5.0	-22.1	84.5	51.0	-	-	-
	가온칩스	53,000	615	22.4	-0.4	35.5	74.9	59.7	-	-
[팹리스]	텔레칩스	12,350	187	11.1	-11.6	-6.0	12.3	-	-	1.0
	칩스앤미디어	16,260	346	15.2	-1.1	5.0	21.1	32.3	43.1	11.9
	퀄리타스반도체	14,560	206	9.8	-12.4	5.4	120.6	-	-	-
	오픈엠티테크놀로지	12,210	269	14.0	-4.8	4.6	15.7	-	-	-
	에이적랜드	29,550	321	5.5	-6.6	3.5	9.0	-	91.8	3.5
	파두	26,850	1,328	19.1	5.7	165.8	61.5	-	-	11.7
	제주반도체	19,060	656	4.9	-7.3	46.2	120.3	15.4	-	-
	에이디테크놀로지	30,700	413	28.5	16.3	109.0	122.1	-	-	-
	자람테크놀로지	34,800	216	9.6	-19.8	-11.1	-14.1	144.7	-	-
	피델릭스	1,132	38	3.8	-6.4	-6.2	-13.9	-	-	-
	어보브반도체	11,210	199	5.7	-11.0	7.6	46.7	47.0	-	-
[OSAT]	하나마이크론	25,450	1,689	2.2	-13.7	144.0	180.5	-	52.0	1.1
	SFA 반도체	4,340	714	9.7	2.2	43.5	36.5	55.1	-	2.0
	두산테스나	46,000	889	7.5	-9.4	65.8	73.6	13.1	221.2	2.8
	네파스	17,460	403	2.7	0.2	125.0	168.6	-	-	-
	LB 세미콘	4,560	265	4.3	-8.2	38.2	35.7	-	-	-
	네파스아크	17,980	219	2.9	-9.6	75.4	80.7	-	-	-
	에이엘티	10,800	97	5.6	-4.0	32.0	77.0	-	-	-
	시그네틱스	800	69	0.0	-7.0	19.9	3.5	-	-	-
	원팩	535	73	5.7	-13.3	9.9	-20.7	-	-	-
	에이팩트	5,290	224	12.2	1.0	149.5	161.9	-	-	-
	아이원플러스	1,079	35	12.0	-10.9	-15.5	96.2	-	-	-
[사설]	신성이엔지	1,618	333	7.2	-12.4	11.5	38.3	-	-	-
	케이엔솔	11,620	151	4.6	1.2	-4.9	-9.2	11.8	-	-
	엑사이엔씨	651	22	0.6	-3.4	-14.5	-6.3	3.4	-	-
	로체시스템즈	9,280	142	2.0	-16.7	-34.4	-37.5	21.8	-	-
	오션브릿지	6,930	69	8.1	-11.6	16.5	50.3	4.7	-	-
	싸이맥스	15,600	170	2.1	-19.1	31.3	95.2	5.7	-	-
	라운테크	7,960	100	9.0	-3.9	5.3	16.0	14.5	-	-
[웨이퍼 핸들러]	싸이맥스	15,600	170	2.1	-19.1	31.3	95.2	5.7	-	-
	라운테크	7,960	100	9.0	-3.9	5.3	16.0	14.5	-	-
[중고 장비]	서플러스글로벌	2,195	81	5.0	-5.6	-11.8	-17.3	19.2	-	-
	러셀	2,000	64	7.6	-8.3	17.8	25.1	9.3	-	-
[자동화 부품]	아진엑스텍	8,910	87	23.6	5.7	29.5	32.4	-	-	-
	이삭엔지니어링	8,510	71	15.0	-3.4	12.3	25.1	-	-	-
[칩 유통]	유니퀘스트	6,240	135	5.2	-18.9	-2.0	24.3	27.1	5.6	0.2
	미래반도체	15,350	222	3.8	-10.2	7.6	33.7	66.1	-	-
	유니트론텍	5,520	116	7.4	-8.5	-3.0	8.4	4.4	-	-
[후공정 소재]	덕산하이메탈	5,770	262	1.8	-12.7	45.0	57.4	8.6	-	1.2
	엠케이전자	8,570	194	3.3	-7.3	11.6	37.1	-	-	-
	비케이홀딩스	904	18	-2.3	-11.4	9.0	37.2	-	-	-
[전기전자]	타이거일렉	19,900	126	15.0	-9.1	60.4	47.4	290.5	-	-
	LX 세미콘	51,900	844	1.6	-9.6	-13.9	-2.6	7.1	10.5	0.5
	해성디에스	52,300	889	4.4	1.8	188.5	149.0	6.8	27.9	1.4
	심텍	51,800	1,912	0.6	-18.0	189.5	385.9	-	-	1.4
	티엘비	66,700	656	-2.2	-2.8	288.3	461.2	35.2	34.5	2.6

자료: 각 사, 유진투자증권 추정

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다
당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다
당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다
동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다
동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에 있습니다
동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다
동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

종목추천 및 업종추천 투자기간: 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함) 당사 투자의견 비율(%)

· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	0%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	97%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	3%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	0%

(2025.09.30 기준)